

证券代码：301041 证券简称：金百泽

深圳市金百泽电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年05月19日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 武守坤先生 独立董事 赵亮先生 独立董事 方先丽女士 独立董事 秦曦先生 董事会秘书 陈鹏飞先生 保荐代表人 丁冬梅女士
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况： 1. 公司去年营收略有增长的，介绍一下营收增长的业务板块，及利润有所下滑的原因？ 答：尊敬的投资者，您好！2024年公司实现营业总收入6.83亿元，同比增长7.39%；归属于上市公司股东的净

	利润0.39亿元，同比下降1.45%。公司营业收入去年实现稳步增长，主要得益于公司深入践行“专行业、精产品、大客户”业务发展策略。2024年总体消费需求低迷，而AI算力、机器人、无人机、新能源汽车、新能源电力与储能技术与设施、物联网与人工智能、电子物料国产替代市场相对迎来发展机遇。公司积极开展人工智能、无人机、新能源、电力、汽车电子智能硬件和电子物料国产替代市场的业务拓展和研发创新，强化行业铁三角服务模式，为客户提供产品解决方案，取得了部分领域的增长，其中智能硬件2024年销售收入为12,192.86万元，同比增长78.28%；物联网2024年销售收入为2,087.33万元，同比增长434.13%。 净利润方面同比有略微地下滑1.45%，主要系：（1）公司报告期内加大了在科创服务及数字化的投入。在科创服务及数字化需求方面，数字化转型和国家科创战略下，电子产品研发与硬件创新蓬勃发展，中小企业对电子电路设计和研发制造的一站式创新、数字化建设服务的需求日益增长；企业也在争夺科技领域的领先地位，这导致对科创服务的需求增加，特别是一站式的技术支持、中试支持、生产支持和人才支持，以促进新技术的研发、加速产品上市、提升创新能力。（2）报告期内行业竞争形势的影响，PCB印制电路板业务销售毛利有略微下降，同时受原材料成本上升等原因导致营业毛利率有所下降。供应方面，中国PCB供应链自主性较强；PCB市场大宗原料如贵金属金、铜价格高位运行并呈上涨趋势，对PCB原材料如覆铜板、半固化片、铜箔供应价格形成低位反弹支撑，总体生产物料成本略有上升；电子元器件除AI相关的芯片与存储芯片价格上涨外，其它应用领域供应平稳。感谢您对公司的关注！
--	---

2. 请问董事长，公司造物数科如何助力产业数字化转型和高质量发展？

答:尊敬的投资者，您好！公司深耕电子电路产业，致力于打造电子电路产业的工业互联网平台。依托金百泽集团二十余年服务“专、精、特、新”客户的经验和产业资源积累，基于“产业互联+云工厂”创新模式，携手华为云共同打造电子电路产业互联网平台。旗下子公司造物数科打造的“应龙造物”品牌，以硬件研发服务为路径，加速“数字平面”和“实体平面”的有机融合，链接研发工具链、工业仿真、行业资源库等一系列面向电子电路产业建立的数字与软件生态，与相关方构建新型网络化研发与制造新范式，深耕产业，协同服务客户，推进各方乃至行业实现协作共赢。造物数科链接产业生态，打造电子电路云工厂新范式。为客户提供从设计到研发、试产到量产的全流程一站式服务。

为企业数字化转型提供软硬一体化解决方案，赋能硬件创新和产业数字化升级。造物数科携手华为云，全力打造“应龙造物”工业互联网平台。该平台实现了研发到制造全流程的数字化，为超过500家中小企业提供了优质的服务。通过平台，企业能够更高效地整合资源，优化生产流程，提升生产效率。落地的智慧云工厂成效显著，订单交付效率提升了30%，客户满意度达到较高水平，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势。感谢您对公司的关注！

3. 请介绍一下未来3-5年的一个详细发展规划，特别是市场拓展这方面，谢谢！

答:尊敬的投资者，您好！未来3-5年在市场拓展方面，

	公司将以“专行业+大科创”与“全球化+本地化”双轮驱动，构建电子电路、电子信息生态行业护城河并开积极拓国内外增量市场。在国内市场，聚焦工业控制、医疗电子、AI驱动下智能制造、低空经济等高潜力赛道，通过IPDM集成设计与制造策略强化技术解决方案能力，打造“硬件+软件+服务”全价值链闭环。在国际市场，深化北美、东南亚的“链式出海”布局，以数字园区模式输出工业互联网驱动的供应链协同能力，计划通过新加坡为东南亚总部辐射海外市场，致力于实现客户扩容及业绩增长。感谢您对公司的关注！ 4. 公司在2024年的研发投入情况？ 答：尊敬的投资者，您好！公司2024年的研发投入约4,578.63万元。公司坚持“专、精、特、新”发展路径，注重以产品服务与技术创新为支撑的高质量发展。通过设计先行，营销拉动技术能力向客户端前置，落实集成设计能力与项目组高效协同能力建设，进一步完善电子产品设计与智能工程实验室能力建设，为客户提供IPDM集成设计与制造服务；强化市场与营销驱动的产品与技术研发，进一步推动产品与服务结构升级；集成内外部技术链资源，积极开展各类线上线下技术交流活动，通过深厚的DFX技术与数据沉淀赋能客户设计与研发工程师；更加主动的融入地方和客户的科技创新和产品创新强链补链工程中，提供科技创新和产品创新方案服务；同时积极推进产学研技术合作，加强高价值专利运营与技术成果转化。感谢您对公司的关注！
--	--

5. 感觉公司和传统的PCB企业不一样，请问公司的主要业务是什么，是否有重大变化？

答:尊敬的投资者，您好！公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，以电子产品技术研发、工程能力、集成设计与制造、供应链为核心能力开展业务，整合内外部供应链资源，建立数字化服务体系，加强产品质量保障，提升客户满意度。为客户提供集成产品设计IPD、集成产品制造IPM、印制电路板PCB及科创服务、数字化转型服务、其他业务等。致力于打造世界级电子产品硬件创新和科创服务集成商。我们以“设计-制造-服务”深度协同为核心，为电子电路、电子信息创新服务，合作客户超过20000家，通过数字化平台整合供应链资源，为中小型客户提供从产品定义、工程开发到柔性化量产、数字化转型的一站式解决方案。感谢您对公司的关注！

6. 请问公司股份回购及股权激励进展？

答:尊敬的投资者，您好！截至2025年3月7日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,280,800股，占公司目前总股本的1.20%，最高成交价为26.00元/股（除权除息后价格），最低成交价为18.10元/股（除权除息前价格），成交总金额为30,007,008.00元（不含交易费用），公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕。本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司高度重视员工激励机制的建设，合理的激励措施能够有效提升员工的工作效率和创造力，公司将根据公司战略和人才发展计划，利用回购股份适时推出员工持股或股权激励等激励方案。公司如有相关计划将严格按照信息披露管理办法等有关规定

	及时进行披露。感谢您对公司的关注！ 7. 请问公司对未来分红有何规划？ 答:尊敬的投资者，您好！自上市以来，公司始终高度重视投资者回报，每年度连续实施现金分红，分配比例均超过当年实际可供分配利润的15%。公司2024年度利润分配预案拟以现有总股本106,680,000股剔除公司回购专用证券账户上的股份1,280,800股后的股本总额105,399,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金股利人民币10,539,920.00元（含税），本年度不进行送红股及资本公积转增股本。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。 上市以来，每年度公司连续实施现金分红，并按照相关法律法规和《公司章程》等规定，制定《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。感谢您对公司的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年05月19日